

CUTTING EDGE

カッティングエッジ

77期事業のご報告

平成27年4月1日～平成28年3月31日

社長メッセージ



会社概要

株式情報



スマートフォン市場の拡大が継続し、高度化するお客様のニーズに素早く対応したことで売上高・利益ともに過去最高を更新しました。今後もお客様に「高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術」を素早く提供できるように、研究開発投資や設備投資を積極的に推進してまいります。

事業環境・業績

2015年度は、スマートフォンの高機能化に伴い半導体・電子部品の需要が拡大したことから、日本や欧米地域のメーカを中心に積極的な設備投資が見られました。特にメモリや電子部品などウェーハ薄化への加工ニーズが拡がりを見せ、グラインダの出荷が大幅に増加しました。また消耗品である精密加工ツールの売上は、円安効果にも支えられ堅調に推移しました。損益については、多様化するお客様の加工ニーズに対応するため高水準の研究開発投資を行いました。付加価値の高い製品の販売が好調だったため、粗利益がさらに改善しました。結果、前年度に続き

売上高・利益ともに過去最高を更新しました。

株主様への還元につきましては、業績連動型の配当に加えて大型設備投資の一眼により生まれた余剰資金を、配当方針により追加配当[※]として当期末配当に上乘せしました。これにより1株当たりの配当金は追加配当を含め年間315円とさせていただきます。

今後の見通し

2016年度は、お客様の量産投資の水準が例年と比べて低い見通しですが、今後もスマートフォンの高機能化や更なる需要の拡大に加え、自動車・ウェアラブルデバイスなど、半導体・電子部品

の用途の拡大が見込まれております。当社も様々なアプリケーションのニーズの拡がりを期待しており、お客様の多様化するニーズに対し、高度な Kiru・Kezuru・Migaku技術を素早く提供できるように、研究開発投資や設備投資を積極的に推進する一方で、社員一人ひとりが自立的に判断し、素早く動ける組織づくりに注力してまいります。株主の皆様におかれましては今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※追加配当について

年度末時点で赤字の場合を除き、配当及び法人税支払い後の現預金残高が予定必要資金額を超過した場合は、業績連動分に加え、超過金額の3分の1を目処に配当に上乘せいたします。

2016年6月

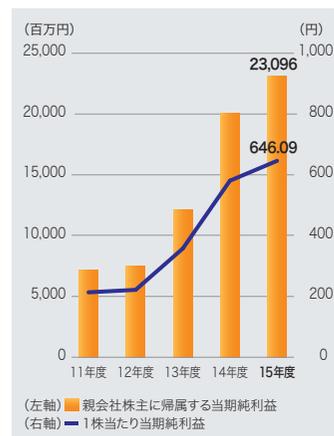
代表取締役社長 関家一馬



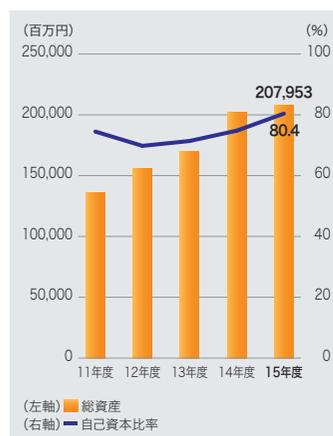
売上高・経常利益・経常利益率



親会社株主に帰属する当期純利益・1株当たり当期純利益



総資産・自己資本比率



キャッシュ・フロー



当期の概況

当期(2015年4月1日から2016年3月31日まで)においては、スマートフォンなどのモバイル機器の需要拡大に関連した投資意欲が旺盛だったことから、半導体・電子部品を生産するメーカ各社は設備投資を積極的に行いました。精密加工装置は、精密切断装置(ダイサ)ではロジックIC向けの需要が低調だった一方、精密研削装置(グラインダ)はフラッシュメモリ向けや電子部品向け、イメージセンサ向けなど幅広いアプリケーションで需要が拡大しました。消耗品である精密加工ツールは、為替の影響などもあり底堅く推移しました。その結果、連結売上高は3期連続で過去最高を更新しました。利益については、積極的な研究開発などにより販売管理費が増加しましたが、為替の影響や製品構成の変化などによりGP率が上昇したことから、営業利益は大幅に増加しました。

以上の結果、当期の業績は売上高1,278億50百万円(前期比1.5%増)、営業利益303億38百万円(同13.4%増)、経常利益306億90百万円(同15.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益230億96百万円(同15.1%増)となり、各利益とも過去最高を更新しました。

■財政状態

当期末の総資産は、前期末と比べ59億78百万円増加し、2,079億53百万円となりました。これは、主にたな卸資産や固定資産が減少した一方で、現金及び預金が増加したためです。負債は、前期末と比べ101億38百万円減少し、399億17百万円となりました。こ

れは、主に仕入債務と有利子負債が減少したことによるものです。純資産は、前期末と比べ161億16百万円増加し、1,680億35百万円となり、自己資本比率は前期末比5.6ポイント増となる80.4%となりました。

■キャッシュ・フロー

営業活動では293億16百万円の資金増加、投資活動では71億74百万円の資金減少だったことからフリー・キャッシュ・フローは221億42百万円の資金増加となりました。これは、投資活動において有形固定資産の取得による資金支出があったものの、税金等調整前当期純利益やたな卸資産の減少などによる資金増加があったためです。財務活動では、主に配当金の支払によって67億34百万円の資金減少となりました。これらの結果、当期末の資金残高は前期末から149億84百万円増加し、571億62百万円となりました。

上半期の連結業績予想

特定の地域やテーマでの設備投資がKiru・Kezuru・Migakuニーズを下支えする見通しではあるものの、半導体メーカ各社の量産投資が例年と比べ低い水準で推移すると見込んでおります。また、為替の影響もあり上半期の業績は減収・減益の予定です。中間期の配当については、1株当たり54円を見込んでおります。

2017年3月期上半期

売上高	営業利益	経常利益	当期純利益	1株当たり当期純利益
55,220	10,200	10,300	7,700	215.17円



「高度な**Kiru・Kezuru・Migaku**技術によって
遠い科学を身近な快適につなぐ」

3つのコア技術を深めることで、ディスコは産業と暮らしに貢献していきます。

「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」とは

ディスコのビジネステーマを指しています。人類に欠かせない普遍的な技術である「切る」「削る」「磨く」という事業領域において、ディスコは世界のオンリーワン企業でありたいと考えています。あえてローマ字で表記しているのは、これらの分野でディスコの技術が世界標準となり、日本語でそのまま通用するようなレベルを目指すという、強い思いが込められているからです。

「遠い科学を身近な快適につなぐ」とは

ディスコの社会的使命(ミッション)を意味しています。日々進歩していく科学技術を、ディスコの「高度なKiru・Kezuru・Migaku技術」によって、人々の暮らしの豊かさや快適さに帰結させていきたい、という考えを表現しています。

ディスコが追い求める成長とは

企業の成長をどのように定義するかによって、経営の方向性は大きく変わります。ディスコの「成長」とは売上やシェア、規模の拡大などに依らず、2つの基準によって評価されています。ひとつはミッションの実現度が高まり、社会により大きく貢献ができているか、もうひとつはお客様・従業員・サプライヤ・株主など、すべてのステークホルダとの価値交換性が向上しているか、です。